# Структура и ориентировки волокон Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, используемых для напыления YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>y</sub>

© Ю.В. Блинова,<sup>1</sup> С.В. Сударева,<sup>1</sup> Е.И. Кузнецова,<sup>1</sup> Т.П. Криницина,<sup>1</sup> О.В. Снигирев,<sup>2</sup> Н.В. Порохов<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Институт физики металлов УрО РАН, 620990 Екатеринбург, Россия <sup>2</sup> Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 119991 Москва, Россия e-mail: sudareva@imp.uran.ru

(Поступило в Редакцию 17 декабря 2014 г. В окончательной редакции 17 марта 2015 г.)

Различными методами исследованы внутренняя структура и ориентация тонких  $(150-300\,\mu\text{m})$  гибких волокон Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, которые используются в качестве подложек для проводов третьего поколения на основе высокотемпературных сверхпроводников. Показано, что использование сканирующей электронной микроскопии, дифракции обратно-отраженных электронов (EBSD), просвечивающей электронной микроскопии, а также рентгенографии позволяет адекватно установить положение плоскости (1102), необходимой для роста качественной пленки YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>y</sub>.

#### Введение

08

При изготовлении электрических проводов так называемого второго поколения из высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП-2) в качестве подложек для напыления буферных слоев и сверхпроводящего слоя YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>v</sub> (Y-123) используются тонкие металлические ленты типа Ni-W. Хорошо известно, что эти композиционные сверхпроводники проводят постоянный электрический ток без потерь. Однако ленточные ВТСП-2 не имеют нулевого сопротивления при протекании переменного тока даже промышленной частоты 50 Hz. Так, в работе [1] показано, что при передаче рабочих токов частотой 50 Hz и величиной 0.6-0.8 от критического потери достигают до 10 W на 1 m длины кабеля. Наибольшие потери в этом случае происходят при наличии перпендикулярной компоненты магнитного поля к плоскости ленты-подложки и большого соотношения ширины ленты к толщине сверхпроводящего слоя Ү-123. В работе [2] показано, что на переменном токе (77.44 Hz) величиной 0.5 от критического  $(j_c = 75.2 \,\text{A/mm}^2)$  в магнитном поле  $10 \,\mathrm{mT}$ , ориентированном под углом  $45^\circ$ к плоскости образца, потери в пленке У-123 на сапфировой подложке (ширина 10 mm, общая толщина 0.11 mm), пересчитанные на единичный объем за период тока, составили 2000 J/m<sup>3</sup>, тогда как при ориентации магнитного поля параллельно плоскости образца потери составляли всего 30 J/m<sup>3</sup>. Потери на переменном токе можно значительно сократить, если использовать немагнитные подложки или значительно уменьшить ширину сверхпроводящего слоя Y-123, разделив его на узкие полоски [3,4].

С учетом этого для изготовления сверхпроводников на основе Y-123 с низкими потерями на переменном токе нужны новые технологии. Данную проблему можно решить, используя в качестве подложек тонкие ( $\sim 150-300\,\mu$ m) гибкие оксидные волокна. Низкое со-

отношение ширины (диаметра) подложки к толщине сверхпроводящего слоя Y-123, отсутствие в подложке проводимости и магнетизма обеспечивают резкое снижение потерь на переменном токе. В настоящее время в качестве подложек для напыления Y-123 апробируются различные оксидные волокна [5,6]. Провода, в которых используется данный тип подложек, принято называть сверхпроводящими проводами третьего поколения (ВТСП-3). Серьезную проблему при этом представляет развитие методов точной характеризации структуры нитевидных подложек, без которой невозможно получение ВТСП-3 проводов с высокими значениями критической температуры и плотности критического тока.

В настоящей работе приведены результаты исследования внутренней структуры и кристаллографической ориентации поверхности сапфирового волокна Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, являющегося одним из перспективных типов подложек для получения не очень длинных ВТСП-3 проводов для охлаждаемых СВЧ-устройств.



**Рис. 1.** Элементарная ячейка сапфира Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; векторы **a**<sub>1</sub>, **a**<sub>2</sub>, **a**<sub>3</sub>, **c** — направления осей координат. Ось **a**<sub>3</sub> лежит в *R*-плоскости.



**Рис. 2.** Волокно Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: *а* — изображение в сканирующем электронном микроскопе, видна уплощенная (темная) поверхность, *b* — EBSD-карта, однородное почернение — приблизительно одна ориентировка, светлые точки — отклонение от этой ориентировки, *c* — небольшая разориентация в пределах уплощенной поверхности, *d* — ориентация уплощенной поверхности волокна (большое темное пятно).

### Методика

Диаметр и длина исследуемого волокна  $Al_2O_3$  составляли ~ 240  $\mu$ m и ~ 3 cm соответственно. Фрагменты волокна были исследованы методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), дифракции обратно-отраженных электронов (EBSD) на приборе Quanta-200, просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) на приборе JEM-200CX, а также рентгенографии (метод Лауэ на просвет). Исследования выполнены на оборудовании ЦКП "Испытательный центр нанотехнологий и перспективных материалов" ИФМ УрО РАН.

Структура соединения  $Al_2O_3$  может быть описана с помощью гексагональной решетки с параметрами a = 4.7589 Å, c = 12.991 Å [7]. Единичная ячейка сапфира  $Al_2O_3$  показана на рис. 1. Хорошо известно, что текстурованный по (001) сверхпроводящий слой Y-123 растет на так называемой *R*-плоскости (1102). На рисунке фрагмент этой плоскости показан стрелкой, как видно, он расположен наклонно к оси **с** и проходит через ось **a**<sub>3</sub>. Обычно волокна сапфира ориентированы вдоль оси **с**, однако в этом случае, как следует из приведенного рисунка, R-плоскость не выходит на поверхность волокна. В работе [5] было выращено волокно с осью роста вдоль  $\mathbf{a}_3$ , в результате чего R-плоскость вышла на поверхность волокна с двух противоположных сторон. В настоящей работе сапфировое волокно  $Al_2O_3$ выращено методом пьедестала с лазерным нагревом [6]. Продольные и поперечные сколы волокна  $Al_2O_3$  получены в жидком азоте.

#### Результаты и обсуждение

На рис. 2, *а* показано изображение волокна  $Al_2O_3$ . В плоскости рисунка находится уплощенная (более темная) поверхность волокна, которая, скорее всего, совпадает с плоскостью (1102). Справа на рис. 2, *а* — отколовшийся фрагмент волокна с полосчатой структурой. На рис. 2, *b* приведена EBSD-карта уплощенной поверхности волокна. Равномерная, однородная окраска карты свидетельствует о наличии приблизительно одной ориентировки в участке размером  $12 \times 9 \,\mu$ m. Отклонение ориентации в пределах области с однородной окраской не превышает  $0.8^{\circ}$  (рис. 2, *c*). Светлые пятныш-



**Рис. 3.** Стереографические проекции для кристалла Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: *a* — выходы нормалей к плоскостям с указанием индексов плоскостей, *b* — выходы нормалей к плоскостям (осей зон) с указанием индексов нормалей [7].



**Рис. 4.** Отколовшийся фрагмент волокна: *a* — EBSD-карта, *b* — разориентация между большой и малой областями, *c* — стереографическая проекция, темное яркое пятно — выход нормали к поверхности, совпадающей с плоскостью рисунка.



**Рис. 5.** Волокно Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: *а* — продольный скол (СЭМ), *b* — пластинчатая структура продольного скола (СЭМ), *с* — стереографическая проекция продольного скола.

ки на рис. 2, *b* указывают на значительное изменение ориентировки. На соответствующей стереографической проекции (рис. 2, *d*), полученной с участка, приведенного на рис. 2, *b*, видно большое темное пятно (указано стрелкой), которое находится вблизи направления  $[1\bar{1}00]$  и относится к области с однородной окраской. Из сравнения рис. 2, *d* и стереографической проекции, представляющей собой выходы нормалей к плоскостям (на рис. 3, *a*, указаны индексы плоскостей), следует, что ориентация уплощенной поверхности волокна близка к *R*-плоскости (1 $\bar{1}02$ ).

Определим ориентацию поверхности отколовшегося фрагмента волокна (рис. 2, a), которая совпадает с плоскостью рисунка. Из соответствующей EBSD-карты (рис. 4, a) видно, что бо́льшая часть поверхности имеет одинаковую ориентировку, за исключением небольшой области, которая обозначена светлыми точками. Разориентация между этими областями (большой и малой) составляет 60° (рис. 4, b). Из соответствующей стереографической проекции (рис. 4, c) следует, что бо́льшая доля поверхности отколовшегося фрагмента находится вблизи *R*-плоскости (1102) — интенсивное пятно вблизи направления [1100] и выхода нормали к плоскости (1102), обозначено ×.

На рис. 5, а приведено изображение продольного скола волокна  $Al_2O_3$ , а на рис. 5, b — его внутренняя пластинчатая структура. Видны большие плоские террасы, которые заканчиваются ступенями. Есть и другие ориентировки пластин, возможно, все они связаны с разными плоскостями типа (1102). Такая пластинчатая структура, на наш взгляд, отражает процесс формирования волокна. Полагаем, что большие пластины (террасы) имеют отношение к *R*-ориентировке, и именно они выходят на поверхность и формируют плоскость (1102), на которой происходит текстурованный рост слоя Ү-123. Отметим, что ориентация выбранного нами места продольного скола для получения EBSD-карты (рис. 5, b) сильнее отклонена по сравнению с поверхностью волокна на рис. 2, *a* от нормали к плоскости  $(1\overline{1}02)$  (рис. 5, *c*) из-за неточности скола. Пластинчатая структура поперечного скола, произведенного при температуре жидкого азота, приведена на рис. 6. Видны пластины разных ориентировок и толстая пачка пластин, параллельная уплощенной поверхности волокна.



**Рис. 6.** Волокно Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (CЭМ): *а, b* — поперечный скол, видны пачки пластин (их торцы), расположенных близко к поверхности волокна.

Мы исследовали ориентировку уплощенной поверхности волокна и методом просвечивающей электронной микроскопии. Само волокно не просвечивается электронами. Для исследования использовали поперечный скол волокна, произведенный в жидком азоте. В результате скола по краям сечения образовались осколки пластин, параллельных уплощенной поверхности волокна и вытянутых вдоль оси образца. С этих осколков и были получены электронограммы. Для определения ориентировки уплощенной поверхности волокна методом просвечивающей электронной микроскопии желательно обладать предварительной информацией об ожидаемой в этом случае оси зоны электронограммы. Поскольку для гексагонального сапфира Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> индексы плоскостей и нормалей к ним (оси зон) не совпадают, получить данную информацию можно, например, из анализа рис. 3, а, b, [7]. Рис. 3, b представляет собой стереографическую проекцию нормалей к плоскостям (индексы плоскостей указаны на рис. 3, a). Из сравнения



**Рис. 7.** Изображение излома (ПЭМ), электронограмма к нему (в правом верхнем углу), расчетная электронограмма для оси зоны [2201].

рис. 3, *а* и *b* следует, что наиболее близко к нормали к плоскости  $(1\overline{1}02)$  подходит направление  $[2\overline{2}01]$ . Именно такие электронограммы с осью зоны  $[2\overline{2}01]$  должны наблюдаться для уплощенной поверхности волокна.

На рис. 7 в нижнем левом углу приведена расчетная электронограмма с осью зоны  $[2\bar{2}01]$  (из работы [7]). На этой электронограмме имеется рефлекс (11.0) с d = 3.794 Å, который связан с направлением вектора решетки  $\mathbf{a}_3$  с индексами  $[11\bar{2}0]$ . Как уже отмечалось, именно это направление должно совпадать с осью волокна. На рис. 7 также показаны изображение излома вдоль оси волокна и экспериментальная электронограмма с этого излома. И как видно после совмещения электронограммы с изображением, вектор  $[11\bar{2}0]$  приблизительно ориентирован вдоль осколка, т.е. вдоль оси волокна.

Подтверждением всего сказанного является результат определения кристаллографической ориентации волокна с использованием метода Лауэ на просвет. Полученные с боковой поверхности волокна лауэграммы показали, что на боковой поверхности волокна имеется фасетка, ориентированная по плоскости (1102).

Развитые методы характеризации кристаллографической структуры нитевидных кристаллических подложек позволяют получать образцы сверхпроводящих проводов третьего поколения и оптимизировать технологию их получения. Так, метод Лауэ использовался для определения ориентации оси образцов фасетированных "монокристаллических" нитей-подложек из диоксида циркония, стабилизированного оксидом иттрия (YSZ), в работе [6], в которой методом лазерной абляции было выполнено напыление буферных слоев СеО2 и сверхпроводящих пленок Y-123 с  $T_c \approx 90 \, \text{K}$  в нулевом магнитном поле и 87.5 К в поле 8 Т, с плотностью критического тока  $j_c \approx 5 \times 10^4 \,\text{A/cm}^2$  (77 K, 0 T). Ранее в работе [5] на правильно ориентированных сапфировых волокнах  $Al_2O_3$  диаметром  $\sim 100\,\mu{
m m}$  с фасетками по *R*-плоскостям (1102) была получена пленка У-123 с критической плотностью тока  $1.2 \text{ MA/cm}^2$  (77 K, 0 T).

## Заключение

Таким образом, в настоящей работе продемонстрировано использование различных методов (сканирующая электронная микроскопия, метод EBSD, просвечивающая электронная микроскопия, метод Лауэ) для определения структуры и ориентировки сапфирового волокна Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, которое апробируется для напыления текстурованных пленок фазы У-123 при получении сверхпроводящих проводов третьего поколения. В отличие от работы [5] обнаружено, что исследуемое волокно Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> состоит из толстых пачек крупных пластин, которые по-разному ориентированы по отношению к оси волокна. Одна из пачек пластин, ориентированных по *R*-плоскости (1102), близко подходит к поверхности волокна, хотя и отклоняется от нее на 3-5°. Наблюдаемое отклонение может быть преодолено, согласно [5], путем небольшого изменения ориентировки затравки и скорости вытяжки волокна. Точная ориентация *R*-плоскости (1102) по поверхности волокна обеспечивает высокую текстуру [001] напыленного слоя 123 и высокую критическую плотность тока.

Работа выполнена по теме "Кристалл" (№ 0120146333) при поддержке проекта УрО РАН № 15-17-2-16 и гранта Минобрнауки 14.604.21.0005 (уникальный идентификатор RFMEFI60414X0005).

## Список литературы

- [1] Fetisov S.S., Zubko V.V., Nosov A.A., Polyakova N.V., Vysotsky V.S. // Phys. Proc. 2011. Vol. 36. P. 1319–1323.
- [2] Jiang Z.N., Amemiya N. // Supercond. Sci. Technol. 2006.
   Vol. 19. N 8. P. 742–747.
- [3] Oberly C.E., Long L., Rhoads G.L., Carr W.J. // Cryogenics. 2001. Vol. 41. N 2. P. 117–124.
- [4] Stavrev S., Grill F., Dutoit B., Ashworth S.P. // Supercond. Sci. Technol. 2005. Vol. 18. N 10. P. 1300–1312.
- [5] Xu Y., Djeu N., Qian Z., Xu Z., He P., Bhattacharya R. // IEEE Trans. Appl. Supercond. 2011. Vol. 21. N 3. P. 3281–3284.
- [6] Чухаркин М.Л., Порохов Н.В., Калабухов А.С., Снигирев О.В., Русанов С.Ю., Кашин В.В., Цветков В.Б., Винклер Д. // Журнал радиоэлектроники (электронный журнал). 2013. N 2.
- [7] Lee W.E., Lagerlof K.P.D. // J. Electron Microsc. Tech. 1985.
   Vol. 2. P. 247–258.